

■ 財務概況

財務概況

損益状況

当期の事業環境

2015年3月期の世界経済は、アジアの一部新興国において成長スピードの鈍化が見られましたが、米国を中心に緩やかな回復基調が続きました。

当社の参画するエレクトロニクス産業においては、新型の高機能スマートフォンの販売が好調となり、中国をはじめとする新興国のスマートフォン市場の拡大もみられました。また、クラウドサービスのさらなる進展とそれに伴うインターネット通信量の急速な増加により、データセンター向けサーバー需要が伸びるなど、電子機器および半導体市場も堅調に推移いたしました。これらを受けて、当社の主な顧客である半導体メーカーの設備投資も前年比約16%増加と大きく伸びました。

売上の状況

当期は、今後のさらなる収益性向上に向けて、経営資源を当社の主力事業である半導体製造装置及びフラットパネルディスプレイ (FPD) 製造装置事業へ集中させる事業再編を実施しました。その一環として、電子部品・情報通信機器事業を手掛ける東京エレクトロン デバイス株式会社の株式の一部を売却し、同社は連結子会社から持分法適用関連会社へ異動しました。これにより、当期より同社は連結対象外となり、売上高については対前期比で1,007億円(前期実績)の減少要因となりました。一方で、当社の主力事業である半導体製造装置事業及びFPD製造装置事業の売上が前述の好調な市場環境を反映し前期比1,018億円増加したことにより、当期の売上高全体としては前期比0.2%増加の6,131億円となりました。また、国内向け売上高は前期比41.2%減少の950億円、海外向け売上高は前期比15.0%増加の5,181億円となり、売上高に占める海外向けの売上高の比率は前期の73.6%から84.5%に10.9ポイント上昇しました。これは主に国内向

け売上高比率が約80%であった前述の東京エレクトロンデバイス株式会社が連結対象外となった影響によるものです。

なお、当期の受注高については、主力の半導体製造装置の受注高が前期比14%以上の増加となりましたが、東京エレクトロン デバイス株式会社の連結除外の影響により、受注高全体としては前期比5.1%減少の6,610億円となりました。また、当期末の受注残高は11.6%増加の2,958億円となりました。半導体製造装置及びFPD製造装置の受注高、受注残高については、P13に記載されているセグメント別の状況をご参照ください。

売上総利益、販売費及び一般管理費、営業利益

売上原価は前期比9.7%減少の3,704億円となり、売上原価率は前期から6.6ポイント低下の60.4%となりました。これにより売上総利益は前期比20.2%増加の2,428億円となり、売上総利益率は前期の33.0%から過去最高となる39.6%へと大幅に向上しました。主な改善要因は、主力の半導体製造装置事業における競争力向上と収益性改善及び、東京エレクトロン デバイス株式会社を連結対象外とした事業再編の効果によるものです。

販売費及び一般管理費(販管費)は、東京エレクトロンデバイス株式会社の連結除外による減少131億円、太陽光パネル製造装置事業の撤退等による研究開発費の減少73億円等により、前期比8.9%減少の1,547億円となりました。売上高販管費比率については、販管費比率の低い東京エレクトロン デバイス株式会社が連結除外となり上昇要因となりましたが、一方で、売上増加に伴い主力の半導体製造装置事業及びFPD製造装置事業の販管費比率が大きく低下したことで、全体としては前期の27.7%から25.2%に低下しました。

これらの結果、営業利益は前期比173.6%増加の881億円、営業利益率は前期の5.3%から14.4%へと大幅に上昇しました。

研究開発費

研究開発費は、前期比9.3%減少の713億円となりました。研究開発費の主な減少要因は、太陽光パネル製造装置事業からの撤退によるものです。対売上高比率については、売上高が前期と同水準のもと研究開発費が減少となったため、前期の12.9%から11.6%に低下しました。当社は、技術開発が成長の源泉であるとの考えのもと、既存分野の強化のみならず、今後の成長が見込まれる新規分野にも投資を行いました。半導体製造装置分野では、半導体のさらなる高速化、大容量化、低消費電力化、低コスト化を実現する先端技術の開発に取り組みました。微細化に対応するマルチパターンニング技術や、新しい三次元構造のデバイスや新材料に対応するエッチング技術、成膜技術、洗浄技術などのキーテクノロジーの開発に注力し、2014年における当社製品のシェア拡大につながりました。また、次世代メモリの有力候補であるSTT-MRAM*用の製造装置開発も進め、一部の製品について顧客の開発ラインに採用されるなどの成果が現れました。

先端パッケージング分野においては、シンガポール科学技術研究庁傘下のInstitute of Microelectronicsとの共同研究を開始し、パッケージングの業界標準技術を確立させ、本格的な量産展開を実現する上で最大の課題となっているコストの低減を目指しています。

FPD製造装置分野では、有機ELパネル製造用インクジェット描画装置の開発を加速させ、顧客の開発ラインでの採用にいたりました。

* STT-MRAM: Spin Transfer Torque-Magnetoresistive Random Access Memory(低消費電力が期待できる磁気メモリ)

その他収益(費用)および当期純利益(損失)

当期は、主な収益として、事業撤退を進めている太陽光パネル製造装置事業に関する土地、建物等の固定資産の売却益18億円、為替差益16億円、受取利息及び受取配当金13億円を計上しました。また、主な費用としては、FPD製造装置事業における中国工場の事業計画の見直しを主とした建物及び生産設備等の減損損失25億円、東京エレクトロン デバイス株式会社の連結除外に伴う関係会社株式売却損16億円、太陽光パネル製造装置事業に関する関係会社整理損11億円、テクノロジーセンターつくば及びテクノロジーセンター仙台の閉鎖に伴う拠点再編費用10億円等、事業再編や資産の効率化を目的とした費用を多く計上しました。これにより、その他収益(費用)は純額で13億円の費用(前期は440億円の費用)となりました。

この結果、税金等調整前当期純利益は868億円(前期は118億円の損失)、当期純利益は719億円(前期は194億円の損失)を計上することとなりました。1株当たり当期純利益は401.08円(前期は108.31円の損失)となりました。

包括利益

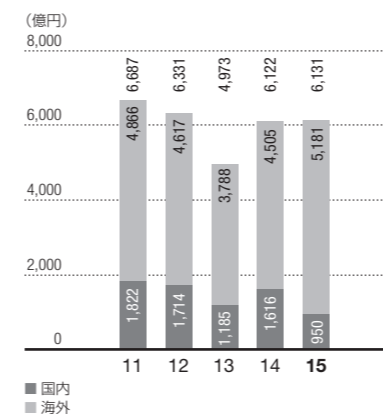
当期は、少数株主損益調整前当期純利益の719億円に加え、円安の影響による為替換算調整勘定66億円および、その他有価証券評価差額金39億円等を計上したことから、包括利益は803億円(前期は109億円の損失)となりました。

配当政策および当期配当金

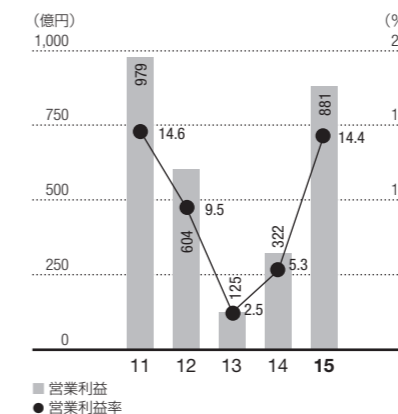
当社は、業績連動型・収益対応型の配当を株主還元の基本方針とし、連結当期純利益に対する配当性向35%を目

	百万円				
損益状況	2011	2012	2013	2014	2015
売上高	¥668,722	¥633,091	¥497,300	¥612,170	¥613,125
売上総利益	234,758	211,445	158,755	201,892	242,774
売上総利益率	35.1%	33.4%	31.9%	33.0%	39.6%
販売費及び一般管理費	136,888	151,002	146,206	169,687	154,661
営業利益	97,870	60,443	12,549	32,205	88,113
営業利益率	14.6%	9.5%	2.5%	5.3%	14.4%
税金等調整前当期純利益(損失)	99,579	60,602	17,767	(11,756)	86,828
当期純利益(損失)	71,924	36,726	6,076	(19,409)	71,888

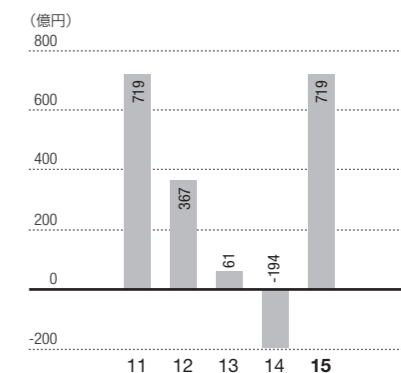
■ 国内および海外売上高



■ 営業利益および営業利益率



■ 当期純利益(損失)



■ 財務概況

財務概況

途とする配当を実施しています。これにより当期の年間配当金は、好調な業績を反映し、過去最高となる1株当たり143円(配当性向35.7%)となりました。今後も利益成長を通して株主の皆様のご支援にお答えしていきます。なお、当期の配当については、アプライド マテリアルズとの経営統合を見込んでいたことから、例外的に四半期ごとの配当を実施しました。(第1四半期配当10円、第2四半期配当30円、第3四半期配当35円、期末配当68円)

セグメント別の状況

■ 半導体製造装置

2014年の世界半導体売上高は、好調なスマートフォン等のモバイル機器の販売やデータセンター向けサーバー需要の高まりを背景に、前年比約8%増加の3,400億米ドルとなる過去最高を記録しました。これにより、半導体前工程設備投資もメモリ、ロジック向けともに活発に行われ、前年比約16%増加となるなど大幅に拡大しました。

このような状況のもと、当社が注力分野として位置付けシェア向上に取り組んでいるエッチング装置と洗浄装置を始め、全ての製品でシェアが増加し、2014年の半導体前工程設備投資市場における当社のシェアは、前年比3.1ポイント上昇の13.6%となりました。洗浄装置においては、微細化に対応した戦略製品の拡販により、過去最高のシェア25%を達成しました。また、パーツ・中古機の販売や改造・保守サービス等を手がけるフィールドソリューション事業についても、微細化の進展と伴に高度な技術力を有する製造装置メーカーへの需要は高まり、売上高が前期比で約35%増加となりました。

これにより、当セグメントの外部顧客に対する売上高は、2014年の半導体前工程製造装置の市場成長率約16%を上回る前期比20.3%増加の5,762億円となりました。セグメント間の内部売上高又は振替高を含む当セグメントの売上高も、前期比20.3%増加の5,762億円となり、セグメント利益は前期比83.1%増加の1,360億円、セグメント利益率は前期の15.5%から大幅に改善し、過去最高と同率の23.6%となりました。

当期の受注高は前期比14.6%増加の6,268億円、期末の受注残高は前期比24.1%増加の2,605億円となりました。当部門の営業概況については、P8をご参照ください。

■ FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

2014年の液晶パネル市場は、主にテレビ向けの需要が拡大したことで、液晶パネル全体の面積需要が前年比10%近い伸びとなりました。これにより、中国における大型液晶パネル向け設備投資が伸長し、FPD製造装置市場も前年比約20%増加となるなど堅調に推移しました。このような状況のもと、高精細の大型液晶パネル向けに技術的な優位性をもつ当社のICP(誘導結合プラズマ)エッチング装置の販売が好調でした。

当セグメントの外部顧客に対する売上高は前期比15.5%増加の327億円となりました。また、セグメント間の内部売上高又は振替高を含む当セグメントの売上高も前期比15.5%増加の327億円となりました。一方で、セグメント損失は、一部の製品において追加費用を計上したことにより、前期の3千7百万円から13億円となりました。

当期の受注高は前期比14.6%減少の353億円、期末の受注残高は前期比8.9%増加の316億円となりました。当部門の営業概況については、P8をご参照ください。

■ PV(太陽光パネル)製造装置

当社は、2014年1月に太陽光パネル製造装置事業からの撤退を表明し、手続きを進めてきました。当期は、顧客に納入済みの装置の主要な作業に関し完了の目途がたったことから、当事業を主に手掛けている当社連結子会社であるTEL Solar AGの解散・清算手続きをすすめる方針を決定し、同社に対する債権放棄を実施しました。この結果、当期に関係会社整理損10億円を計上しました。

当セグメントの外部顧客に対する売上高は前期の38億円から36億円となりました。セグメント間の内部売上高

又は振替高を含む当セグメントの売上高は前期の38億円から36億円、セグメント損失は前期の464億円から88億円となりました。

当期の受注高は、事業撤退手続きに伴う顧客との販売条件の見直し等により17億円減少となりました。期末の受注残高は前期比58.9%減少の37億円となりました。

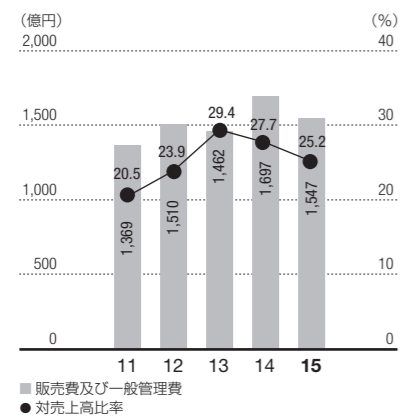
当部門の営業概況については、P8をご参照ください。

■ その他

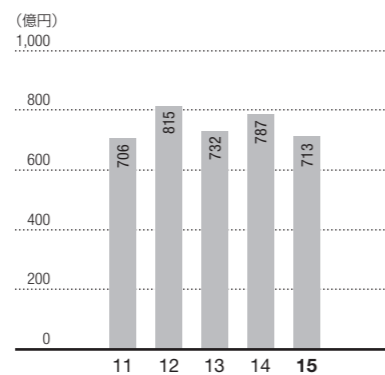
その他の売上は、当社グループの物流、施設管理および保険業務等の内部サービス関連業務の売上です。なお、当部門の外部顧客に対する売上高は、前期比15.8%増加の6億円となりました。

セグメント情報	報告セグメント				合計	調整額	連結財務諸表計上額
	半導体製造装置	FPD製造装置	PV製造装置	その他			
2015:							
売上高							
外部顧客への売上高	¥576,242	¥32,710	¥3,618	¥ 555	¥613,125	¥ —	¥613,125
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	11,443	11,443	(11,443)	—
計	576,242	32,710	3,618	11,998	624,568	(11,443)	613,125
セグメント利益又は損失	135,992	(1,312)	(8,789)	1,169	127,060	(40,232)	86,828
セグメント資産	305,583	23,751	1,731	1,891	332,956	543,198	876,154
減価償却費	10,018	427	6	42	10,493	10,385	20,878
のれんの償却額	1,150	—	—	—	1,150	—	1,150
減損損失	388	509	—	—	897	1,609	2,506
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	8,530	197	—	23	8,750	5,530	14,280

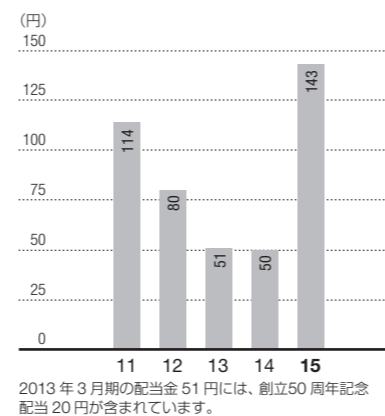
■ 販売費及び一般管理費対売上高比率



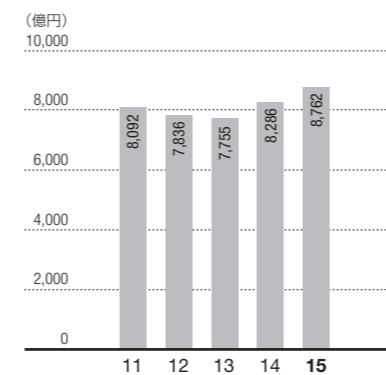
■ 研究開発費



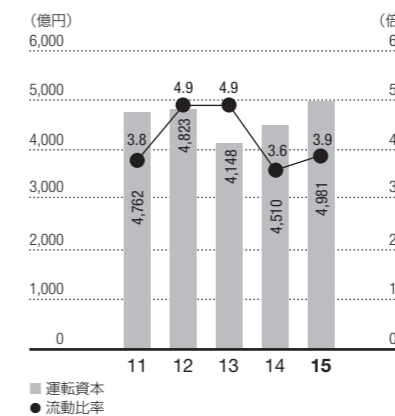
■ 1株当たり配当金



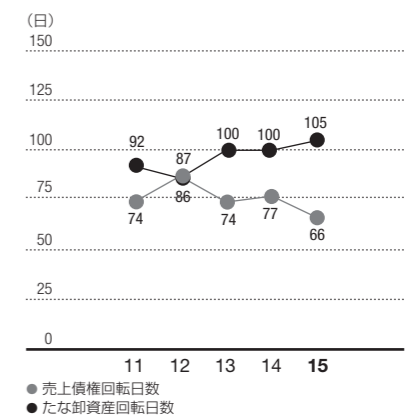
■ 総資産



■ 運転資本および流動比率



■ 売上債権回転日数およびたな卸資産回転日数



■ 財務概況

財務概況

財政状態およびキャッシュ・フロー

資産、負債及び純資産

■ 資産

流動資産は、前期末に比べ494億円増加し、6,709億円となりました。主な内容は、手元流動性(現金及び現金同等物に取得から満期日までが1年内の短期投資を加えたもの)の増加495億円、たな卸資産の増加73億円、前払費用及びその他流動資産の増加69億円、受取手形及び売掛金の減少182億円によるものであります。なお、売上債権回転日数は前期の77日から66日に改善、たな卸資産回転日数は前期の100日から105日とわずかに悪化しました。

有形固定資産は、新規取得分が132億円ありましたが、減価償却実施額181億円、FPD製造装置事業における中国工場の生産設備等の固定資産減損21億円等を差し引き、純額で54億円減少の1,069億円となりました。

投資その他の資産は、前期末から36億円増加し、984億円となりました。主な要因は、投資有価証券の増加39億円です。

これらの結果、総資産は前期末から476億円増加し、8,762億円となりました。

■ 負債及び純資産

流動負債は、前期末に比べ23億円増加し、1,728億円となりました。主として、前受金の増加85億円、賞与引当金の増加35億円、支払手形及び買掛金の増加28億円、未払法人税等の減少78億円、未払費用及びその他流動負債の減少51億円によるものです。

長期負債は、退職給付に係る負債26億円の減少、繰延税金負債10億円の減少を主要因に、前期末に比べ53億円減少し、622億円となりました。

当期末の長期・短期合わせた有利子負債の残高は、有利子負債を有していた東京エレクトロン デバイス株式会社の連結除外により、前期の135億円からゼロとなりました。

流動負債と長期負債を合わせた負債合計は、前期末に比べ30億円減少して2,350億円となりました。

純資産は、前期末に比べ505億円増加し、6,412億円となりました。主として、当期純利益719億円と配当金179億円(前期末、当期第1四半期、第2四半期、第3四半期配当の合計)の計上等による利益剰余金の増加526億円、円安による為替換算調整勘定の増加67億円、東京エレクトロン デバイス株式会社の連結除外等による少数株主持分の減少106億円によるものであります。

この結果、自己資本比率は前期から3.2ポイント上昇し、73.0%となりました。また、自己資本当期純利益率(ROE)は前期の-3.3%から11.8%に上昇しました。

■ 設備投資額*および減価償却費**

当期の設備投資額は、前期と比較して3.0%増加の132億円となりました。主に、半導体製造装置事業において、高成長が期待できる分野を中心に研究開発向けのプロセス評価用装置等の取得を行いました。

減価償却費は、前期から設備投資を抑制していることから、前期と比較して16.1%減少し、209億円となりました。

* 設備投資額は有形固定資産の増加分を示しています。
** 減価償却費にはのれん償却額および減損損失は含まれていません。

■ キャッシュ・フロー

営業活動により獲得したキャッシュ・フローは、前期比274億円増加の718億円となりました。主な内容として、税金等調整前当期純利益868億円、減価償却費209億円、前受金の増加129億円、支払手形及び買掛金の増加94億円がそれぞれキャッシュ・フローの増加要因となり、たな

卸資産の増加268億円、法人税等の支払額242億円、未収消費税等の増加114億円がそれぞれキャッシュ・フローの減少要因となりました。

投資活動により獲得したキャッシュ・フローは、前期の196億円の支出に対して1,557億円の収入となりました。主として、定期預金及び短期投資の純減少による収入1,633億円、有形固定資産の取得による支出119億円によるものです。

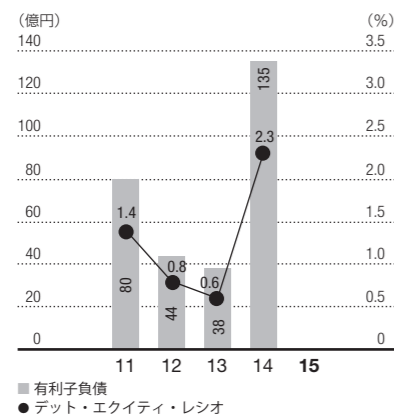
財務活動により支出したキャッシュ・フローは、主に配当金の支払179億円により、前期の2億円に対し182億円となりました。

現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ2,128億円増加し、3,176億円となりました。なお、現金及び現金同等物に取得から満期日までが1年内の短期投資を加えた残高(手元流動性)は、前期末に比べ495億円増加し、3,177億円となりました。

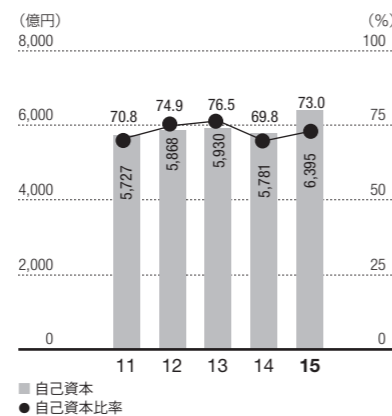
財政状態	百万円				
	2011	2012	2013	2014	2015
流動資産	¥644,231	¥607,051	¥521,501	¥621,492	¥670,883
有形固定資産	112,552	126,885	135,698	112,344	106,896
投資その他資産	52,422	49,675	118,329	94,756	98,375
総資産	809,205	783,611	775,528	828,592	876,154
流動負債	168,038	124,794	106,670	170,510	172,812
負債合計	224,403	185,008	170,401	237,978	234,991
純資産	584,802	598,603	605,127	590,614	641,163

キャッシュ・フロー	百万円				
	2011	2012	2013	2014	2015
営業活動によるキャッシュ・フロー	¥ 83,239	¥ 29,712	¥ 84,267	¥ 44,449	¥ 71,806
投資活動によるキャッシュ・フロー	(35,882)	(8,352)	(141,769)	(19,599)	155,738
財務活動によるキャッシュ・フロー	(5,237)	(27,335)	(10,625)	(187)	(18,214)
現金及び現金同等物期末残高	165,051	158,776	85,314	104,797	317,632

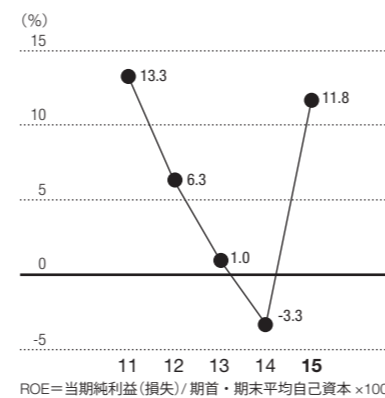
■ 有利子負債およびデット・エクイティ・レシオ



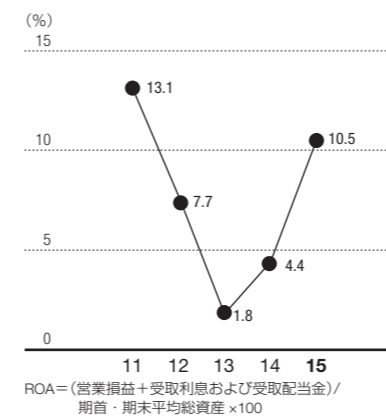
■ 自己資本および自己資本比率



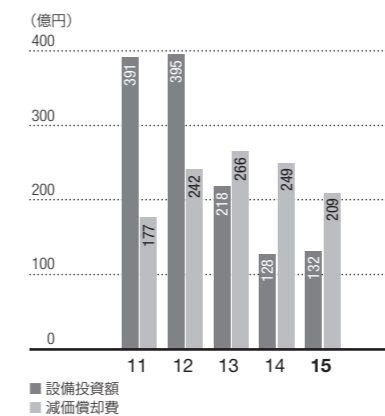
■ ROE



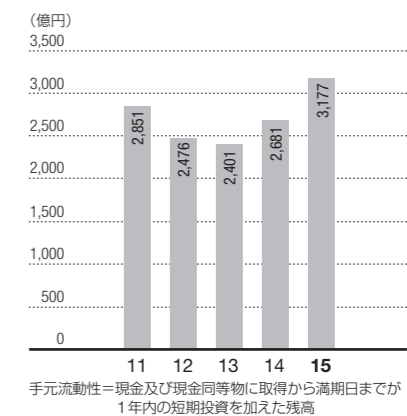
■ ROA



■ 設備投資額および減価償却費



■ 手元流動性



■ 財務概況

財務概況

事業等のリスク

当社の経営成績、財務状況及び当社株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

(1)半導体市場変動による影響

当社は、技術革新が激しく自らの強みを発揮できる半導体製造装置等のハイテク分野に資源を集中させることにより、高い利益率を獲得してきました。半導体市場は技術の変化により大幅に成長する反面、需給バランスが崩れることによって市場規模が一時的に縮小することがあるため、当社はこのような局面においても利益を生み出せるように構造改革にも積極的に取り組んできました。しかしながら、予期せぬ市場規模の大幅な縮小によって、受注取消、過剰設備・人員、在庫増加、顧客の財務状況悪化による貸倒損失、仕入先の経営状態悪化による供給不足等が発生する場合には、当社業績に少なからず悪影響を及ぼす可能性があります。

(2)特定顧客への取引集中による影響

当社は、優れた最先端技術を搭載した製品及び顧客満足度の高いサービス体制を通じて、国内の大手半導体メーカーを含む、世界中の主要な大手半導体メーカーとの取引拡大に成功してきました。大手半導体メーカーの大規模設備投資のタイミングによっては売上が特定の顧客に一時的に集中することがあり、販売競争の激化によって当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3)研究開発による影響

当社は、微細加工技術、真空技術、プラズマ技術、熱処理技術、塗布・現像技術、洗浄技術、ウェーハ搬送技術、クリーン化技術等の最先端技術について積極的な研究開発投資及び研究開発活動を継続的に実施することにより、最先端の技術を創造するとともに、当該技術を搭載した新製品を早期市場投入することによって当社が参入する各製品分野において上位の市場シェアと高い利益率の獲得に成功してきました。しかしながら、新製品投入タイミングのずれ等の影響により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4)安全に関する影響

当社は、開発・製造・販売・サービス・管理等の各種業務の遂行において安全や健康に対する配慮を常に念頭において行動するという基本理念のもと、当社製品の安全性向上や健康影響排除のために積極的かつ継続的に努力しております。しかしながら、当社製品に関連する安全性等の問題により、顧客への損害発生、受注取消等が発生した場合、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5)品質に関する影響

当社は、優れた最先端技術を積極的に開発し新製品に搭載し早期に市場に投入すると同時に、ISO9001の認証取得を含む品質保証体制の確立、及びレベルの高いサービス体制の確立にも努め、その結果、当社の製品を多くの顧客に採用していただくことができました。しかしながら、当社の製品が最先端技術製品である等の原因によって、未知の分野の開発技術も多く存在し、予期せぬ不具合品が発生する等により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6)知的財産権に関する影響

当社は、製品の差別化と競争力強化のために、最先端技術早期開発のための研究開発戦略を事業戦略及び知的財産戦略と三位一体で推進することにより、多くの独自技術の専有化を可能とし、各製品分野における高い市場シェアと利益率の確保に成功してきました。しかしながら、当社の製品は多くの最先端技術が統合・最適化された製品であることもあり、第三者の技術や特許その他の知的財産権を使用する上で制約される場合等があるため、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7)外国為替変動による影響

当社は、事業の積極的な海外展開に成功したことにより、海外への売上高比率が高くなっております。当社の輸出は為替リスクを回避するために円建て取引にて行うことを原則としておりますが、一部外貨建て輸出も存在し、その場合には受注時の先物為替予約等によって為替リスクヘッジに努めております。しかしながら、急激な為替変動によって価格の変動が生じ為替リスクとなることがあり、当社業績に間接的に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8)企業買収による影響

当社は、事業戦略の一環として、新たな事業領域への進出、新技術・ビジネス基盤の獲得、既存事業の競争力強化などを目的とした企業買収を実施することがあります。具体的な実施にあたっては入念な調査・検討を行っております。しかしながら、買収後に当初期待した成果が十分に得られなかった場合には、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(9)重要な訴訟等に関するリスク

当社は、現在においてその業績に重要な影響を与えうる訴訟等に関与しておりませんが、当社の事業活動等が今後重要な訴訟等の対象となり、その結果によっては当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(10)その他リスク

当社は、新たな高成長・高収益事業の創出、既存事業における更なる高収益の追求、市場規模縮小時においても利益を生み出すことのできる体質への改善に積極的に取り組むとともに、環境保全活動の推進、コンプライアンスやリスク管理体制及び情報セキュリティ管理体制の再整備にも取り組んできました。しかしながら、当社が事業を遂行する限りにおいては、同業他社及び他業種企業と同様に、世界及び各地域における経済環境、自然災害、戦争、テロ、感染症等の不可抗力、金融・株式市場、政府等による規制、仕入先の供給体制、商品・不動産市況、国内外での人材確保、標準規格化競争、重要人材の喪失等の影響を受け、場合によっては当社業績に悪影響を及ぼすことが想定されます。